

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2024-040

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 11 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临 2024-016）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-021）等相关文件。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：

注册号：913200007746765307

名称：苏州晶方半导体科技股份有限公司

法定代表人：王蔚

公司住所：苏州工业园区汀兰巷 29 号

注册资本：人民币 652,171,706 元

实收资本：人民币 652,171,706 元

公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：研发、生产、制造、封装和测试集成电路产品，销售本公司所生产的产品并提供相关的服务。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年10月10日